**SCI\EI會議推薦**：第2屆IEEE智慧製造與工業物流工程國際會議（SMILE 2019）暨2019 半導體智慧製造國際研討會（ISMI2019）會議通知

第2屆IEEE智慧製造與工業物流工程國際會議（SMILE 2019）暨2019半導體智慧製造國際研討會（ISMI2019）， 由IEEE、臺灣清華大學和天津大學主辦，浙江大學承辦。**本會議將於2019年4月19-21日在中國杭州召開。**

SMILE&ISMI 2019旨在傳播智慧製造、工業工程及物流工程等方向的最新理論研究、成果展示和實踐案例。

該會議已經邀請數個SCI期刊主編做主題報告或以如何撰寫、發表高水準學術論文做專題講座。會議設論文競賽環節，將對優秀論文以表彰並優先推薦SCI期刊發表。

會議網址：<http://smile.ieeng.org/>

徵收學術論文發表，所收錄的論文將以會議論文集的形式出版並EI檢索（SMILE 2018的論文集已EI檢索），選中的優秀論文將推薦至SCI期刊發表。我們期待著您的關注和參與。

投稿連結：<https://easychair.org/conferences/?conf=smile2019>

**會議的關鍵字：**智慧製造，工業互聯網，人工智慧，智慧計算，工業工程，智慧物流，機械工程，產品設計等，具體請見附件Call For Paper。

**主題報告人及嘉賓（部分）：**

Professor Andrew Kusiak, the University of Iowa, USA, Editor-in-chief of Journal of Intelligent Manufacturing

Professor Tae-Eog Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea, President of Korea Institute of Industrial Engineers (KIIE)

Professor Hing Kai Chan, Ningbo Nottingham University, China, Co-editor of Industrial Management & Data Systems

Professor Lee, Gyu M., Pusan National University, South Korea, Editor-in-Chief of International Journal of Industrial Engineering: TAP

Professor Gen, Mitsuo, Fuzzy Logic Systems Institute, Japan, Editor-in-Chief of Industrial Engineering & Engineering Management

     （更多專家將會加入我們，敬請期待……）

如果您有任何問題或建議，請聯繫會議秘書處，郵箱: [smile\_ismi2019@163.com](mailto:smile_ismi2019@163.com)。

另外，希望您在您的圈子裡能為我們的活動做一下宣傳。感謝支持

杭州自秦朝設縣治以來已有2200多年的歷史，曾是吳越國和南宋的都城。因風景秀麗，素有“人間天堂”的美譽。杭州得益于京杭運河和通商口岸的便利，以及自身發達的絲綢和糧食產業，歷史上曾是重要的商業集散中心。杭州人文古跡眾多，西湖及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡，具代表性的有西湖文化、良渚文化、絲綢文化、茶文化，以及流傳下來的許多故事傳說成為杭州文化代表。著名的旅遊勝地有瑤琳仙境、桐君山、雷峰塔、嶽廟、三潭映月、蘇堤、六和塔、宋城、南宋禦街、靈隱寺、跨湖橋遺址等。

SMILE&ISMI 2019秘書處